

中信证券股份有限公司

关于中微半导体（深圳）股份有限公司

2022 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责中微半导上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 |
|----|---|--|
| 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。 |
| 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 保荐机构已与中微半导签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。 |
| 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | 2022 年上半年度中微半导在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。 |
| 4 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。 | 2022 年上半年度中微半导在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。 |
| 5 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解中微半导经营情况，对中微半导开展持续督导工作。 |
| 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 2022 年上半年度，保荐机构督导中微半导及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 |

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 |
|----|--|---|
| | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。 |
| 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 保荐机构督促中微半导体依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。 |
| 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | 保荐机构对中微半导的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中微半导的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。 |
| 9 | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保荐机构督促中微半导体严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。 |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | 保荐机构对中微半导的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。 |
| 11 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。 | 2022 年上半年度，中微半导体及其控股股东、实际控制人不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。 |
| 12 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。 | 2022 年上半年度，中微半导体及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。 |
| 13 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | 2022 年上半年度，经保荐机构核查，中微半导体不存在应及时向上海证券交易所报 |

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 |
|----|---|---------------------------------|
| | 市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。 | 告的情况。 |
| 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | 2022 年上半年度，中微半导体未发生相关情况。 |
| 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 | 2022 年上半年度，中微半导体不存在需要专项现场检查的情形。 |

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）技术风险

1、产品研发风险

公司作为芯片设计公司，为适应市场新需求和新变化，坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计的技术要求高、工艺复杂，且流片成本较高，若公司产品研发失败，存在前期投入资金无法收回的风险。

公司正在从事的主要研发项目包括大家电主控芯片研发项目、车规级 MCU 系列芯片研发项目、基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目、下一代电机系列芯片项目、IGBT 及功率器件研发项目和动力电池 BMSSoC 研发项目等。上述新产品研发的开发周期较长、资金投入较大，若公司在产品规划阶段未能及时跟踪市场需求走向，或未能维持研发人员的稳定性及研发体系的稳健运作，或在研项目的下游产品技术路径、应用场景等未获市场认可，将对公司未来业绩造成一定影响；此外，若公司研发投入未能及时产业化、技术人才储备无法适应行业的技术形势，导致公司市场竞争中处于落后地位，无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品，可能会对公司市场份额和核心竞争力产生一定影响。

2、技术泄密风险

集成电路设计行业技术密集型的特征日益凸显，拥有核心技术及高素质的研发人员是公司生存和发展的根本。若因核心技术人员流动、技术泄密，或知识产权措施不力等原因，造成公司核心技术流失，可能在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的核心竞争力产生不利影响。

(二) 经营风险

1、供应商风险

公司属于 Fabless 模式集成电路设计公司，存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。近年来，随着半导体需求的增长以及产业链格局的变化，半导体行业的晶圆和封测需求快速上升，上游产能逐步趋紧，采购价格呈上涨趋势。由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此行业集中度较高。如果公司的供应商发生不可抗力的突发事件或未能及时开拓新的供应商，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。报告期内，晶圆产能需求矛盾趋于缓和，封测产能充分释放趋于供大于求状态。

2、市场周期性的风险

公司 MCU 产品主要包括家电控制、消费电子、电机与电池、传感器信号处理、功率器件和汽车电子芯片，其中小家电和消费类占比较高。受全球消费能力下降和整个市场周期性影响，家电行业的景气程度和下游客户经营情况会较大程度地影响公司芯片的使用需求。若未来家电和消费类市场需求萎缩，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

3、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

(三) 财务风险

1、应收账款回收风险

报告期下游市场需求下滑，公司相应改变销售策略、放宽了账期，导致应收账款增加明显，公司应收账款账面价值由 2021 年末的 4,626.99 万元增加至 2022 年 6 月末的 20,007.29 万元，同比增长 332.40%。如果未来公司无法及时收回应收账款，可能对公司的现金流和整体经营造成不利影响。

2、毛利率波动风险

公司产品主要应用于家电、消费电子、电动工具、医疗健康、短距离交通和新能源、汽车电子等多个领域，其毛利率水平受市场供求关系、产品技术先进性、产品更新及结构变化、公司销售及市场策略等因素影响。2021 年，受市场供给影响，公司各产品毛利率均大幅提高；2022 年上半年，由于市场周期性出现，公司产品出现毛利率大幅回落，小家电、消费类产品毛利率回到历史同期水平，公司产品综合毛利率由 2021 年度的 68.94% 回落到 46.62%；公司推出的功率器件，由于处于推广期和受整个功率器件毛利率影响，该类产品毛利率不高；大家电和汽车电子芯片，毛利率相对较高，不同应用领域、不同型号产品的销售结构变化也会对各类产品毛利率造成影响。

3、税收优惠政策风险

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。公司预计 2022 年能继续符合该项优惠政策的认定条件，企业所得税按 10% 的优惠税率计缴；由于研发投入加大，四川中微芯成预计今年能够达到国家鼓励的重点集成电路设计企业指标，获利年度未超过 5 年，按免征企业所得税计提。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，公司将需要补缴 2022 年度企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定影响。

4、存货跌价风险

2022 年 6 月末，公司存货账面价值由 2021 年末的 25,613.53 万元增至 35,213.93 万元，同比增长 37.48%。公司存货主要由原材料、委托加工物资和库存商品构成。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。2020 年下半年起，由于产业链产能紧张，公司对晶圆进行了提前备货，存货账面价值增长较快。报告期内，下游需求放缓，公司库存增加；若未来市场出现长期不景气情况，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

5、净资产收益率及每股收益下降风险

本次发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率及每股收益较大幅度下降的风险。

6、汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售和采购、以美元报价和结算的情况。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内

外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

（四）行业政策风险

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，我国目前已通过一系列法律法规及产业政策，从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持等角度，大力推动行业发展。如果目前良好的行业政策环境发生负面变化，将对集成电路产业的发展产生一定的影响。除此之外，国际间的贸易摩擦，以及有关国家的贸易保护主义抬头以及美国近期通过的《芯片与科学法案》，可能会对公司的新品研发和营收产生影响。公司将继续重视市场、产品、供应链等方面的多元化布局，抓住供应链本土化的时机，实现公司业务快速发展。

（五）业绩下滑风险

2022年1-6月，公司实现营业收入41,438.26万元，较上年同比变动-22.52%；实现归属于母公司股东的净利润4,461.05万元，较上年同比变动-82.75%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,138.95万元，较上年同比变动-56.29%。2021年第四季度以来，半导体行业供应紧张逐步缓解。由于半导体行业供需紧张缓解，下游市场供求关系发生变化，公司产品销售单价及毛利率有所降低。同时，2022年3月份以来，受新冠疫情影响，公司的业务开展受到了一定影响，下游芯片市场需求出现短期异常波动。受半导体行业供需紧张缓解、新冠疫情等因素影响，或者公司未能及时提供满足市场需求的产品和服务，或者公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题，将导致公司未来营业收入产生波动，或因成本费用上升等因素导致净利润产生波动。此外，声光电科股票公允价值的潜在变动预计将拉低公司归属于母公司股东的净利润。极端情况下，无法完全排除公司因上述因素等影响出现上市当年营业利润同比下滑50%以上的可能。

四、重大违规事项

2022半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 414,382,622.33 | 534,841,521.11 | -22.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,610,457.84 | 258,601,173.82 | -82.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,389,506.87 | 254,823,622.17 | -56.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,831,576.80 | 230,585,987.76 | -199.67 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,356,115,111.91 | 1,310,676,653.59 | 3.47 |
| 总资产 | 1,512,337,712.45 | 1,512,492,199.47 | -0.01 |
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.77 | -82.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.77 | -82.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.76 | -56.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 39.16 | -35.81个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.36 | 38.58 | -30.22个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.73 | 6.28 | 5.45 |

1、2022年上半年实现销售收入41,438.26万元，较去年同期下降22.52%。公司主要产品分为家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片、传感与信号处理芯片、功率器件芯片和汽车电子芯片。2021年上半年，受市场需求情况影响，公司芯片产品单价较高，2022年上半年公司产品单价逐步回落至正常水平。因此2022年上半年虽然出货量增加，但营业收入较去年同期有所下降。

2、2022年上半年实现归属于上市公司股东的扣非净利润11,138.95万元，比去年同期下降56.29%；2022年上半年归属于上市公司股东的净利润4,461.05万元，比去年同期下降82.75%。主要原因为，受市场需求变化影响，公司2021年平均毛利率达到近70%，2022年上半年产品平均毛利率逐步回落至公司正常水平46.62%，虽然公司出货量较同期有较大幅度增加，但销售收入和毛利率较去年同期有所下降，同时公司2022年上半年加大了研发力度，增加了研发人员，研发费用较去年同期有明显增长，归属于上市公司股东的扣非净利润随之下降；归属上市公司股东净利润下降幅度较大，主要原因是，2021年下半年上市公司

声光电科以发行股份的方式购买了公司持有的参股子公司重庆中科芯亿达电子有限公司的全部股份，2021 年公司持有的声光电科股票产生的公允价值变动损益金额较大，2022 年上半年声光电科股价下降，造成公司半年度公允价值变动损益为-8,197.07 万元。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-22,983.16 万元，主要系存货和应收账款增加所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要系公司净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

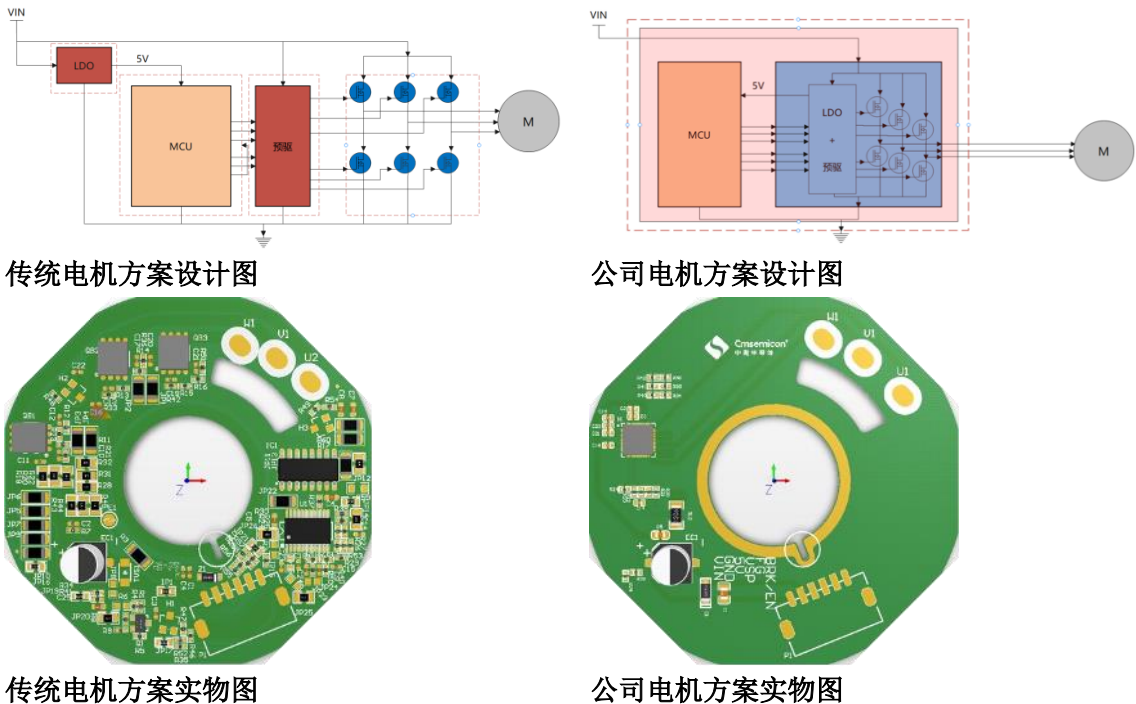
公司在芯片设计领域深耕 20 余年，不断拓展自主设计能力，积累的自主 IP 超过 1,000 个，具有技术全面、产品线丰富、人才团队建设完善、供应链保障度高的特点。在智能化、物联网、新能源等领域对芯片需求持续增长、中美贸易摩擦引发的国产替代意识增强、新冠肺炎疫情等多重因素叠加的背景下，全球范围内出现了芯片产能紧张的局面，芯片成为制约国家电子行业发展的瓶颈，半导体行业迎来全民专注和国家产业政策的大力支持。面对挑战与机遇，公司凭借竞争优势，把握时代的发展机遇。

1、技术布局全、应用领域广

公司围绕智能控制器所需芯片和算法进行技术与产品布局，经过 20 余年的技术积累，具备主流系列 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频、高性能触摸和底层核心算法的设计能力，掌握各类自有 IP 超过 1,000 个；产品在 55 纳米至 180 纳米 CMOS 工艺、90 纳米至 350 纳米 BCD、高压 700V 驱动、双极、SGTMOS、IGBT 等工艺制程上投产，可供销售产品 900 余款，可满足多个细分领域不同客户对芯片功能、资源、性价比的差异化需求。全面的技术能力，使公司成为平台型的芯片设计企业，实现了芯片的结构化和模块化开发，针对不同细分领域可快速推出具有竞争优势的产品，还可为客户提供差异化、定制化服务。产品广泛应用于家电、消费类、电机与电池、物联网、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域，具有应用领域广的优势。

2、整合能力强、集成程度高

公司始终追求集成电路的本质，通过全面的设计技术（数字、模拟、功率器件设计能力）提升外围电子的整合能力、提高产品集成度，提高产品性能、降低综合成本，提升产品综合竞争力。以公司电机 SoC 芯片为例，与传统方案相比，公司单芯片集成了 MCU、LDO、预驱、3 颗（P+N）MOS，一颗芯片实现了传统方案 6 颗芯片的功能，公司电机方案与传统方案的设计图与实物图对比情况如下：



3、团队协同好、平台型开发

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的关键因素是人才。公司结合不同城市的地域特点、人才储备优势和贴近市场需求进行研发团队的布局，并于 2018 年在成都购置 16 亩土地建造 22,000 平方米的研发中心，形成以成都为研发中心，以中山、重庆、北京、上海、新加坡等技术团队为支撑的“一个中心、多点支撑”的技术布局；团队分别为 IP 设计部、数字产品部、模拟产品部和功率器件部以及应用开发支持部门。

公司以 MCU 为核心的研发平台成熟，自有 IP 过 1000 个，面向具体应用定义产品后进行模块化、结构化设计，新产品设计，开发边际成本低，开发周期短，市场导入快，新领域营收增长快。

4、合作程度深、产能保障好

公司与主要供应商稳定合作多年。2001 年与封测厂天水华天合作，携手共同成长；2005 年与晶圆厂华虹宏力合作在国内率先推出 8 位 MCU 芯片，开启全方位、全产线深度合作，2021 年在 3 个工艺实现量产，是华虹 12 寸厂 90/55nmFlash 工艺首发客户，同时也是少有的在其所有工艺全部量产客户；2013 年与晶圆厂 GLOBALFOUNDRIES 合作，并开发自有 EE 存储 IP 使用至今；同时公司寻求多晶圆厂、多工艺合作，确保晶圆产能持续增加以支撑公司快速发展；2014 年与测试厂广东利扬芯片建立芯片测试合作。长期合作所积累的信誉与共同增长的产能供给与需求，加深了公司与主要供应商之间的合作，形成了合作共赢、共同发展的战略合作伙伴关系，增强供应链合作黏性，在产能上得到较为稳定的保证。此外，公司在四川遂宁建设有产能调节型的封装测试产线，增强公司封装测试的应急能力和工程批芯片即封即测的能力，提高新产品研发验证效率。

5、产品应用经验丰富、产品定义贴近市场

公司创始团队具备多年芯片应用开发经验，对终端产品应用场景具有深刻的理解。2001 年公司从芯片产业链的应用开发端走向前端的研发设计，继承了芯片应用开发基因和对应用开发认识的天然优势，善于从应用端和客户功能需求角度定义芯片、规划产品，充分认识到应用开发对芯片市场推广、更新迭代的作用，保持了强大的应用开发队伍，长期对产品进行应用研究和对客户进行技术支持，促进公司产品快速推广，降低了客户开发难度，同时在对客户服务和交流中掌握终端产品的功能需求，并将获得的信息反馈给设计前端，使公司在新产品定义或升级换代中准确响应终端需求，设计出市场定位准、资源配置恰当、性能优越、性价比高、竞争力强的芯片产品。

6、产品系列全、客户群体多

公司产品系列全，包括通用 MCU（8 位、32 位）、专用 ASIC、混合信号 SoC、功率驱动、功率器件等，对应的应用领域广、市场空间大。公司产能在各产品线、领域中高效调节与配置，确保产能消耗和实现更大产能附加值；公司客户群体多，2021 年前 20 大客户销售占比 39.63%，客户关系均衡，抗市场风险和持续盈利能力强。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司持续加大研发投入，公司研发技术人员增至 288 人，研发人员比例达到了 55.81%；研发投入为 4,860.51 万元，占营业收入比例为 11.73%。

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 费用化研发投入 | 48,605,141.02 | 33,585,254.17 | 44.72 |
| 资本化研发投入 | - | - | 不适用 |
| 研发投入合计 | 48,605,141.02 | 33,585,254.17 | 44.72 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 11.73 | 6.28 | 5.45 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - | - | 不适用 |

报告期内，公司新一代车规级 MCU BAT32A 系列已经发布，面向空调室外机主控和工控领域的高性能 MCU 已经流片，功率器件 SGT MOS、IGBT 和 CSP MOS 已经量产出货。2022 年上半年，公司新申请境内发明专利 7 项，获得境内发明专利批准 4 项；新申请境内实用新型专利 7 项，获得境内实用新型专利批准 6 项；新申请软件著作权 4 项，获得软件著作权批准 3 项。截至 2022 年 6 月末，公司累计申请发明专利 50 项，获得授权的发明专利 19 项；累计申请实用新型专利 33 项，获得授权的实用新型专利 32 项；累计申请软件著作权 13 项，获得授权的软件著作权 13 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

发行人于 2022 年 8 月 5 日上市，2022 年 6 月 30 日募集资金尚未到账，不适用。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 6 月 30 日，中微半导体实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

| 序号 | 姓名 | 任职 | 直接持股比例 | 间接持股情况 | 合计持股比例 | 2022 年 1-6 月的质押、冻结及减持情况 |
|----|-------------|--------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 1 | YANGYONG | 董事长 | 37.35% | 1.49% | 38.84% | 无 |
| 2 | 周彦 | 董事、总经理 | 27.21% | - | 27.21% | 无 |
| 3 | 周飞 | 董事 | 4.00% | - | 4.00% | 无 |
| 4 | 王继通 | 董事、副总经理 | - | 1.26% | 1.26% | 无 |
| 5 | LIU ZEYU | 董事、副总经理、销售总监 | - | 0.19% | 0.19% | 无 |
| 6 | 陈凯 | 董事 | | | | |
| 7 | 王毅 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 8 | 华金秋 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 9 | 吴敬 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 10 | 蒋智勇 | 监事会主席 | 4.80% | - | 4.80% | 无 |
| 11 | 罗勇 | 监事 | 4.80% | - | 4.80% | 无 |
| 12 | 冯超 | 监事 | - | 0.11% | 0.11% | 无 |
| 13 | MIAO XIAOYU | 副总经理、技术总监 | - | 0.19% | 0.19% | 无 |
| 14 | 李振华 | 副总经理、产品总监 | 0.13% | 0.67% | 0.80% | 无 |
| 15 | 吴新元 | 董事会秘书、财务总监 | - | 1.16% | 1.16% | 无 |

截至 2022 年 6 月 30 日，中微半导体实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2022 半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

许艺彬

王 彬

中信证券股份有限公司

2022年 9 月 2 日